

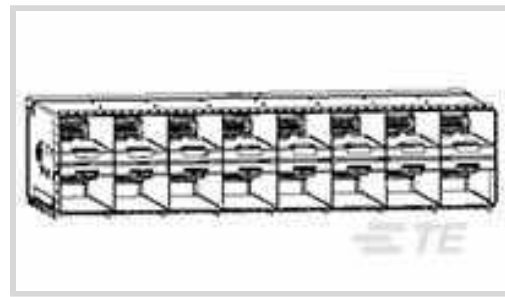
2-2198346-0 ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer 2-2198346-0
SFP, SFP+ & zSFP+, Cage Assembly with Integrated Connector,
Data Rate (Max) 32 Gb/s, Internal/External EMI Springs, zSFP+
Thermally Enhanced

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Pluggable IO-Steckverbinder und -Cages > SFP, SFP+ und zSFP+ > zSFP+ Zweireihiger Cagesatz: EMI-Feder



Steckbarer I/O – Produkttyp: Cagesatz mit integriertem Steckverbinder

Datenrate (max.): 32 Gb/s

Art der EMV-Eindämmung: Interne/externe EMV-Federn

Steckbare I/O-Anwendungen: zSFP+ Thermally Enhanced

Lichtleiter-Optionen: Mit Lichtleiter

[Alle zSFP+ Zweireihiger Cagesatz: EMI-Feder \(45\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Formfaktor	zSFP+ Gestapelt (SFP28)
Gehäusotyp	Zweireihig
Steckbarer I/O – Produkttyp	Cagesatz mit integriertem Steckverbinder
Lichtleiter-Optionen	Mit Lichtleiter
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anschlussmatrixkonfiguration	2 x 8
Lichtleiterkonfiguration	Umgekehrt außen
Lichtleiterausführung	Standard
Anzahl der Anschlüsse	16
Anzahl von Positionen	320

Elektrische Kennwerte

Datenrate (max.)	32 Gb/s
------------------	---------

Kontaktmerkmale

Endstückbeschichtungsmaterial	Zinn
-------------------------------	------

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 µm[29.92 µin]
---	-------------------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel
--	--

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	1.8 mm[.07 in]
-------------------------------	----------------

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
-------------------------------------	-------------------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Nickel-Silberlegierung
-----------------	------------------------

Raster	.8 mm[.032 in]
--------	----------------

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.5 mm[.059 in]
--------------------------------	-----------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Kühlkörperkompatibel	Nein
----------------------	------

Zur Verwendung mit steckbaren I/O-Produkten	zSFP+ SMT-Steckverbinder
---	--------------------------

Steckbare I/O-Anwendungen	zSFP+ Thermally Enhanced
---------------------------	--------------------------

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Tray
--------------------	------

Weitere

Art der EMV-Eindämmung	Interne/externe EMV-Federn
------------------------	----------------------------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)
--	---

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN
2023 (233)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.

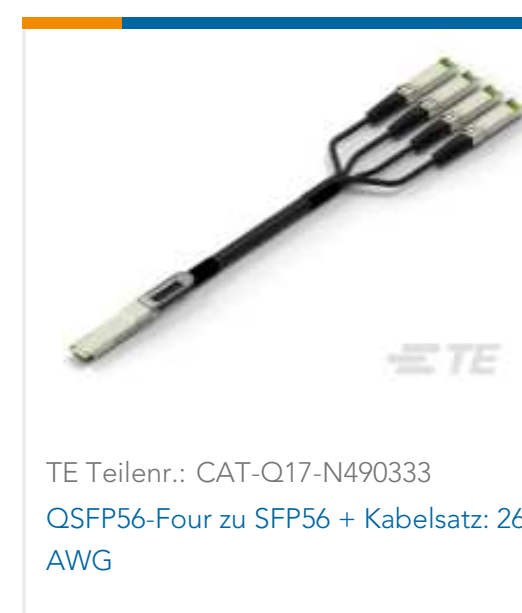
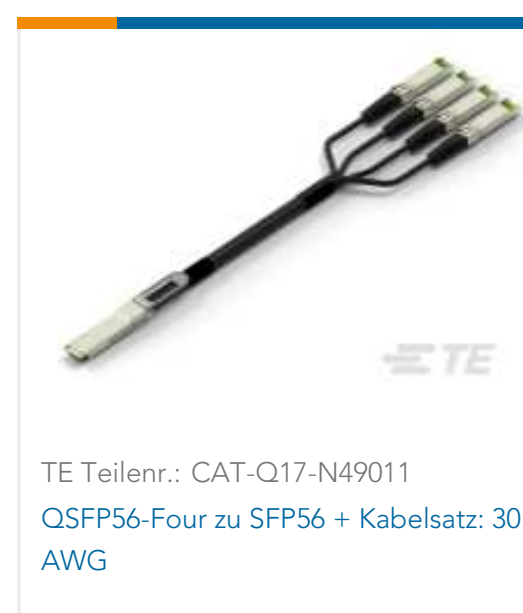
Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile





Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-2198346-0_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-2198346-0_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-2198346-0_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[zSFP+ Interconnect Brochure](#)

Englisch



[Produktspezifikationen](#)

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch